

东莞低温红胶批发

发布日期: 2025-09-29

SMT贴片红胶常见问题:

1、推力不足

推力不足的原因有:1。胶量不足。2. 胶体没有100%固化 3.PCB板或元器件被污染。4. 胶体本身是易碎的，没有强度。

2、胶量不够或漏点

原因及对策: 1。印刷用网板未定期清洗。应每8小时用乙醇清洗一次。2. 胶体中有杂质。3. 网板开孔不合理、过小或点胶压力过小，设计出胶量不足。4. 胶体中有气泡。5. 如果点胶头堵塞，请立即清洁分配喷嘴。6. 如果点胶头的预热温度不够，则应将分配头的温度设置为38℃。

3、拉丝

拉丝是指点胶时贴片胶无法断开，且贴片胶在点胶头移动方向呈丝状连接的现象。有接丝较多，贴片胶覆盖在印制焊盘上，将导致焊接不良。特别是当尺寸较大时，使用点涂喷嘴时更容易出现这种现象。贴片胶拉丝主要受其主成份树脂拉丝性的影响和对点涂条件的设定 SMT红胶贴片加工工艺的常见问题和解决方法。东莞低温红胶批发

常见的SMT贴片红胶不良现象：施红胶不稳定、粘接不到位：施红胶不稳定、粘接不到位的原因有：1、冰箱中取出就立即使用；2、涂覆温度不稳；3、涂覆压力低，时间短；4、注射筒内混入气泡；5、供气气源压力不稳；6、胶嘴堵塞；7、电路板定位不平8、胶嘴磨损；9、胶点尺寸与孔内径不匹配。施红胶不稳定、粘接不到位的解决方法：1、充分解冻后再使用；2、检查温度控制装置；3、适当调整涂覆压力和时间；4、分装时采用离心脱泡装置；5、检查气源压力，过滤齐，密封圈；6、清洗胶嘴；7、咨询电路板供应商；8、更换胶嘴；9、加大胶点尺寸或换用内径较小的胶嘴。东莞低温红胶批发SMT贴片红胶的用途有哪些？

SMT贴片红胶基本知识及应用指南:

关于SMT贴片红胶 SMT贴片红胶是一种聚稀化合物，与锡膏不同的是其受热后便固化，其凝固点温度为150℃，这时，红胶开始由膏状体直接变成固体。

SMT贴片红胶的性质:

SMT贴片红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。根据红胶的这个特性，故在生产中，利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面，防止其掉落。

于印刷机或点胶机上使用:

- 1、为保持贴片胶的品质，请置于冰箱内冷藏（5±3℃）储存；
- 2、从冰箱中取出使用前，应放在室温下回温2~3小时；

3、可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管点胶：

- 1) 、在点胶管中加入后塞，可以获得更稳定的点胶量；
- 2) 、推荐的点胶温度为30–35°C；
- 3) 、分装点胶管时，请使用特用胶水分装机进行分装，以防止在胶水中混入气泡 刮胶：推荐的刮胶温度为30–35°C 注意事项：红胶从冷藏环境中移出后，到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品，不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。

常见的SMT贴片红胶不良现象：

元件偏移：造成元件偏移的原因有：1、红胶胶粘剂涂覆量不足；2、贴片机有不正常的冲击力；3、红胶胶粘剂湿强度低；4、涂覆后长时间放置；5、元器件形状不规则，6、元件表面与胶粘剂的粘合性不协调。元件偏移的解决方法：1、调整红胶胶粘剂涂覆量；2、降低贴片速度，3、大型元件较后贴装；4、更换红胶胶粘剂；5、涂覆后1H内完成贴片固化。元件掉件：造成元件掉件的原因有：

- 1、固化强度不足或存在气泡；
- 2、红胶点胶施胶面积太小；
- 3、施胶后放置过长时间才固化；
- 4、使用UV固化时胶水被照射到的面积不够；
- 5、大封装元件上有脱模剂。

元件掉件的解决方法：

- 1、确认固化曲线是否正确及红胶粘胶剂的抗潮能力；
- 2、增加涂覆压力或延长涂覆时间；
- 3、选择粘性有效时间较长的红胶胶粘剂或适当调整生产周期，
- 4、涂覆后1H内完成贴片固化。
- 5、增加胶量或双点施行胶，使红胶胶液照射的面积增加；
- 6、咨询元器件供应商或更换红胶粘胶剂 SMT红胶主要用来将元器件固定在印制板上。

SMT贴片红胶的主要性能指标和评估：铺展/塌落性：贴片胶不仅要黏牢元件，还应具有润湿能力，即铺展性。不应过分地铺展，否则会出现塌落，以致漫流到焊盘上造成焊接缺陷。通过铺展/塌落试验来考核贴片胶初粘力及流变性。固化性能：贴片胶应能在尽可能低的温度，以较快速度固化。固化后胶点表面硬化、光滑。如果贴片胶固化性能不好，一旦升温速度过快，贴片胶中夹杂的空气、水气以及挥发性物质来不及挥发，就可能导致固化后的贴片胶出现表面不平滑、孔和气泡，不只影响了粘接强度，而且在波峰焊或清洗时，气泡或孔吸收助焊剂、清洗剂，从而导致电气性能的降低 SMT贴片红胶要放在2–8°C的冰箱中保存，防止由于温度变化，影响特性。东莞低温红胶批发

SMT贴片红胶使用知识大全及常见问题点解决方案！东莞低温红胶批发

贴片红胶的特点及应用：

贴片红胶是一种聚稀混合物。其主要成分为基材（即主要高分子材料）、填料、固化剂、其他添加剂等 SMT贴片红胶具有粘度、流动性、温度和润湿性等特点。根据红胶的这一特点，生产中使

用红胶的目的是使零件牢固地附着在印刷电路板的表面，防止其脱落。因此，贴膜是一种纯消费过程的产物。使用**SMT**贴片红胶的目的：（1）防止波峰焊（波峰焊）过程中元件脱落。使用波峰焊时，元件固定在印刷电路板上，以防印刷电路板通过焊接槽时脱落。（2）在回流焊中，防止另一侧部件脱落（双面回流焊工艺）。在双面回流焊过程中，为了防止大型设备因焊接侧的焊料熔化而脱落，采用了**SMT**补片。（3）防止构件位移和位置（回流焊工艺、预涂工艺）。用于再流焊工艺和预涂工艺，防止安装过程中板料移位和立板。（4）标记（波峰焊、回流焊、预涂）。此外，当批量变化时，贴膜还用于标记印刷电路板和元件。东莞低温红胶批发